

Prozessor

Welche gängigen "Processor Packaging" Arten gibt es ?

DIP "Dual Inline Package" Dies sind alle Prozessoren oder Chips mit jeweils einer Reihe Pins links und rechts an der Unterseite. Frühe Intel-Prozessoren, wie der 8086 oder der 8088, sowie Speicher-Chips weisen diese Verpackung auf. Heutige BIOS-Chips werden noch immer in dieser Verpackung geliefert.

PGA "Pin Grid Array" Bei dieser Art der Verpackung befinden sich die Pins in mehreren Reihen an allen vier Seiten an der Unterseite des PGA. Prozessoren wie der 80386, 80486 und der Pentium wurden im PGA ausgeliefert.

PPGA "Plastic Pin Grid Array" Hierbei wird noch zusätzlich das Material angegeben, aus dem die Prozessor-Verpackung gefertigt ist: Plastik. Die neueste Version des Celeron Prozessors wird im PPGA ausgeliefert.

CPGA "Ceramic Pin Grid Array" Hierbei wird noch zusätzlich das Material angegeben, aus dem die Prozessor-Verpackung gefertigt ist: Keramik. Die AMD K6 und K6-2 Prozessoren werden beispielsweise in CPGA ausgeliefert.

FCPGA "Flip Chip Pin Grid Array" Die neueste Generation der Pentium III Prozessoren kommt in dieser Verpackung. Hierbei sind der Prozessorkern und der 2nd Level Cache Chip wie bei einem Hamburger übereinander gelegt und in einem PGA verpackt.

SECC "Single Edge Contact Cartridge" Dies ist eine Steckkarte, auf welcher Prozessorkern und 2nd Level Cache Chip nebeneinander sitzen und in einem Plastikgehäuse fest verkapselt sind. Es gibt SECC für Slot 1, Slot 2 und Slot A. Der Pentium II und der Pentium II/III Xeon sowie der AMD Athlon werden in einer SECC ausgeliefert.

SECC 2 ist im Grunde gleich wie SECC, verwendet aber weniger Plastik in der Verkapselung. Da auch die Halterung geändert wurde, passt ein SECC2-Prozessor nicht automatisch auf ein Board mit einer SECC-Halterung. Der Pentium II und der Pentium III werden auch in einer SECC 2 ausgeliefert.

SEPP "Single Edge Processor Package" Dies ist eine Steckkarte wie SECC, es wurde jedoch auf eine Verkapselung verzichtet. Eine SEPP ist im Grunde eine SECC ohne Gehäuse und kann daher auf den meisten SECC-Boards eingesetzt werden. Manche Celeron Prozessoren wurden in einem SEPP ausgeliefert.

MMO "Mobile Module" ist die Verpackung, welche in Notebooks und portablen Computer verwendet wird. Prozessor, Cache und Chipsatz sind auf einer kleinen Platine vereint und sind über einen speziellen Anschluss mit dem Mainboard des Notebooks verbunden. Der Pentium MMX und der Pentium II sind beispielsweise im MMO verfügbar.

TCP "Tape Carrier Packaging" In dieser Verpackung werden rohe Chips zur Auslieferung an OEMs verpackt, wo sie dann auf die Platinen gelötet werden. In

Prozessor

manchen Notebooks wird zum Beispiel auf MMO verzichtet und der Prozessor direkt aufgelötet.

Eindeutige ID: #1023

Verfasser: Hardwareecke.de

Letzte Änderung: 2005-11-07 17:13